证券代码：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2025-029

盛美半导体设备（上海）股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2025年5月20日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十次会议在中国（上海）自由贸易试验区月桂路999弄B2栋会议室举行，本次会议应出席董事6名，实际出席会议的董事6名。全体董事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由董事长HUI WANG先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决情况：6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决情况：6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的公告》（公告编号：2025-032）。

（三）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

表决情况：6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》及《关于2024年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告》（公告编号：2025-031）。

（四）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

表决情况：6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度向特定对象发行A股股票论证分析报告（二次修订稿）》。

（五）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

表决情况：6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》。

（六）审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

表决情况：6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》（公告编号：2025-033）。

（七）审议通过了《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》

表决情况：6票赞成，占全体董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2025年5月22日

证券代码：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2025-030

盛美半导体设备（上海）股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年5月20日，盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十九次会议在中国（上海）自由贸易试验区月桂路999弄B2栋会议室举行。本次会议应出席监事3名，实际出席会议的监事3名。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设备（上海）股份有限公司章程》《盛美半导体设备（上海）股份有限公司监事会议事规则》的相关规定，合法有效。

会议由监事会主席TRACY DONG LIU女士主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（四）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（五）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

（七）审议通过《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）的议案》

表决情况：3票赞成，占监事人数的100%；0票弃权；0票反对。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司
监事会
2025年5月22日

证券代码：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2025-031

盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于2024年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月20日召开了第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行A股股票预案进行了修订。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。

本次公司向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的披露事项不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行A股股票相关事项的实质性判断、确认、批准或注册，预案所述本次向特定对象发行A股股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机构的批准或注册，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2025年5月22日

证券代码：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2025-032

盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"盛美上海"或"公司"）于2025年5月20日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合自身实际情况对向特定对象发行股票方案中的募集资金金额相关事项进行了调整，募集资金总额由450,000.00万元变更为448,200.00万元，"研发和工艺测试平台建设项目"拟使用募集资金投入的金额由94,034.85万元变更为92,234.85万元。除此之外，公司本次发行方案的内容不存在其他变化。

本次调整前后募集资金投向情况如下：

一、调整前募集资金投向情况

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过450,000.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	研发和工艺测试平台建设项目	94,034.85	94,034.85
2	高端半导体设备迭代研发项目	225,547.08	225,547.08
3	补充流动资金	130,418.07	130,418.07
合计		450,000.00	450,000.00

二、调整后募集资金投向情况

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过448,200.00万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟使用募集资金投资金额
1	研发和工艺测试平台建设项目	94,034.85	92,234.85
2	高端半导体设备迭代研发项目	225,547.08	225,547.08
3	补充流动资金	130,418.07	130,418.07
合计		450,000.00	448,200.00

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2025年5月22日

证券代码：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2025-034

盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于向特定对象发行A股股票预案及相关文件修订情况说明的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度向特定对象发行A股股票相关议案已由第二届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会、第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议、2025年第一次临时股东大会审议通过。

公司根据最新情况，于2025年5月20日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告（二次修订稿）的议案》《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》等相关议案。

本次拟对向特定对象发行股票预案及相关文件进行相应修订，除修订了本次发行相关事项已履行和尚需履行的决策程序外，其他修订具体情况如下：

一、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
重大事项提示	重大事项提示	1、更新列示审议本次向特定对象发行股票的相关事项的董事会、股东大会； 2、更新本次发行的股数上限； 3、更新本次发行的募集资金金额以及各募投项目的投入金额
第一节 本次向特定对象发行股票方案概要	一、发行人基本情况	更新公司基本信息
	四、（五）发行数量	更新本次发行的股数上限
	四、（六）募集资金投向	更新本次发行的募集资金金额以及各募投项目的投入金额
	六、本次发行是否导致公司控制权发生变化	更新公司总股本、本次发行的股数上限以及发行后控股股东持股比例的测算情况
	八、本次发行方案已取得的批准以及尚需呈报批准程序	更新列示审议本次向特定对象发行股票的相关事项的董事会、股东大会
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行的募集资金金额以及各募投项目的投入金额
	二、（一）研发和工艺测试平台建设项目	1、根据2024年数据，更新公司研发人员数量及学历情况 2、更新"研发和工艺测试平台建设项目"的募集资金投入的金额
	二、（二）高端半导体设备迭代研发项目	1、更新2024年度公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比增长率； 2、更新公司专利相关的数据
	二、（三）补充流动资金项目	更新2024年度公司营业收入同比增长率
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	六、（一）对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素	1、更新公司应收账款、存货、汇兑收益、毛利率、资产总额数据； 2、新增公司及部分子公司被列入"实体清单"的风险
	六、（二）可能导致本次发行失败或募集资金不足的因素	更新本次发行的股数上限
第四节 公司利润分配政策及执行情况	二、公司最近三年现金股利分配情况	更新公司最近三年现金分红情况
第五节 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、更新公司本次发行的募集资金总额； 2、根据2024年财务数据和发行方案更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提以及对公司主要财务指标的影响分析
	四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司在人员、技术、市场储备情况的相关数据和表述

二、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票论证分析报告（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
五、本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	五、（一）本次发行符合《公司法》、《证券法》相关规定	更新列示审议本次向特定对象发行股票的相关事项的董事会、股东大会
	五、（四）公司本次向特定对象发行股票符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见证券期货法律适用意见第18号》（以下简称"证券期货法律适用意见第18号"）的相关规定	更新本次发行的募集资金总额
	五、（五）本次发行程序合法合规	更新列示审议本次向特定对象发行股票的相关事项的董事会、股东大会
六、本次发行方案的公平性、合理性	六、本次发行方案的公平性、合理性	更新列示审议本次向特定对象发行股票的相关事项的董事会、股东大会
七、本次发行对原股东权益或者即期回报摊薄的影响以及填补的具体措施	七、（一）本次发行对公司主要财务指标的影响	根据2024年财务数据和发行方案更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提以及对公司主要财务指标的影响分析
	七、（四）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司在人员、技术、市场储备情况的相关数据和表述

三、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次募集资金使用计划	一、本次募集资金使用计划	更新本次发行的募集资金金额以及各募投项目的投入金额
二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析	二、（一）研发和工艺测试平台建设项目	1、更新公司研发人员数量及学历情况； 2、更新"研发和工艺测试平台建设项目"的募集资金投入的金额
	二、（二）高端半导体设备迭代研发项目	1、更新2024年度公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比增长率； 2、更新公司专利相关数据
	二、（三）补充流动资金项目	更新2024年度公司营业收入同比增长率

四、《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
一、本次发行对公司主要财务指标的影响	一、本次发行对公司主要财务指标的影响	1、根据2024年财务数据和发行方案更新本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设前提以及对公司主要财务指标的影响分析； 2、更新本次发行的股数上限
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	四、（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况	更新公司在人员、技术、市场储备情况的相关数据和表述

五、《盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明（二次修订稿）》的修订内容

章节	章节内容	修订情况
二、项目方案概述及必要性、可行性分析	二、项目方案概述及必要性、可行性分析	更新本次发行的募集资金金额以及各募投项目的投入金额
	二、（一）研发和工艺测试平台建设项目	1、更新公司研发人员数量及学历情况； 2、更新"研发和工艺测试平台建设项目"的募集资金投入的金额；
	二、（二）高端半导体设备迭代研发项目	1、更新2024年度公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比增长率； 2、更新公司专利相关数据
	二、（三）补充流动资金项目	更新2024年度公司营业收入同比增长率

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司
董事会
2025年5月22日

证券代码：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2025-035

盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2025年6月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月12日　9点00分

召开地点：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新元南路388号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月12日

至2025年6月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15~9:25,9:30~11:30,13:00~15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15~15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于2024年年度报告及摘要的议案	√
2	关于2024年度董事会工作报告的议案	√
3	关于2024年度监事会工作报告的议案	√
4	关于2024年度财务决算报告的议案	√
5	关于2025年度财务预算方案的议案	√
6	关于2024年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案	√
8	关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案	√

注：本次股东大会还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2025年2月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2024年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）登载《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：ACM RESEARCH, INC.、持有公司股票的董事、监事对议案8回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688082	盛美上海	2025/6/4

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记资料

1.法人股东

法定代表人出席会议的，应提交法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2.个人股东

个人股东亲自出席会议的，应提交本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应提交本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记安排

拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年6月10日16时之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱ir@acmrcsh.com进行出席登记（出席现场会议时查验登记材料原件）。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

（一）参会股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式：

联系部门：盛美上海董事会办公室

电话：021-50276506

邮箱：ir@acmrcsh.com

特此公告。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事会
2025年5月22日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

盛美半导体设备（上海）股份有限公司：

兹委托　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月12日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于2024年年度报告及摘要的议案			
2	关于2024年度董事会工作报告的议案			
3	关于2024年度监事会工作报告的议案			
4	关于2024年度财务决算报告的议案			
5	关于2025年度财务预算方案的议案			
6	关于2024年度利润分配预案的议案			
7	关于续聘公司2025年度审计机构的议案			
8	关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688082　　证券简称：盛美上海　　公告编号：2025-033

盛美半导体设备（上海）股份有限公司关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

盛美半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议、2024年第一次临时股东大会、第二届董事会第十四次会议、第二届董事会第十六次会议、2025年第一次临时股东大会、第二届董事会第二十次会议审议通过了公司2024年度向特定对象发行A股股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的相关要求及公司财务数据及经营情况，公司就本次2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）对普通股股东权益和即期回报可能造成的影响进行了分析，结合实际情况提出了填补回报措施，相关主体对填补回报措施能够切实履行作出了承诺，具体内容如下：

一、本次发行对公司主要财务指标的影响

本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过人民币448,200.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于研发和工艺测试平台建设项目、高端半导体设备迭代研发项目和补充流动资金。

（一）测算假设及前提

以下假设仅为测算本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

1、假设本次发行预计于2025年9月完成。该完成时间仅用于计算本次发行对摊薄即期回报的影响，最终以经证监会注册并实际发行完成时间为准。

2、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。

3、假设本次募集资金总额为不超过人民币448,200.00万元（含本数），暂不考虑发行费用等影响。假设本次发行数量为不超过公司发行前总股本的10%，即不超过44,129,118股（含本数）。在预测公司总股本时，仅考虑本次发行股份的影响，不考虑股权激励、期权激励、转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的变化。

4、公司2024年扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为110,884.67万元，假设2025年度实现的归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润相比2024年度存在增长20%、持平、减少20%三种情形，依此测算2025年归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润。该假设仅用于计算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响，并不代表公司对未来经营情况及趋势的判断，亦不构成公司盈利预测。

5、本次向特定对象发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以实际发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。

6、在计算发行在外的普通股股数时，仅考虑本次发行对总股本的影响，不考虑股权激励、期权激励、股票回购注销、公积金转增股本等导致股本变动的情形。

7、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次发行对每股收益等主要财务指标的影响，具体情况如下表所示：

项目	2024年度/2024年12月31日	2025年度/2025年12月31日	
		本次发行前	本次发行后
期末总股本（万股）	43,874.08	44,129.12	48,542.03
假设1：2025年度实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2024年度增长20%			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	110,884.67	133,061.60	133,061.60
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	2.54	3.02	2.95
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	2.51	2.99	2.92
假设2：2025年度实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2024年度保持不变			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	110,884.67	110,884.67	110,884.67
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	2.54	2.52	2.45
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	2.51	2.49	2.43
假设3：2025年度实现的扣除非经常性损益后归属于上市公司普通股股东的净利润较2024年度减少20%			
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润（万元）	110,884.67	88,707.74	88,707.74
扣除非经常性损益后基本每股收益（元/股）	2.54	2.01	1.96
扣除非经常性损益后稀释每股收益（元/股）	2.51	1.99	1.94

注：基本每股收益和稀释每股收益的计算按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》中的规定进行计算。

二、本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产规模将有所增加。鉴于募集资金的使用和产生效益需要一定周期，在公司股本和净资产均增加的情况下，如果公司业绩暂未获得相应幅度的增长，本次向特定对象发行完成后公司的即期回报（每股收益等财务指标）将存在被摊薄的风险。此外，一旦前述分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况发生变化的可能性。

公司盈利水平假设仅为测算本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不代表公司对经营情况和趋势的判断，亦不构成公司盈利预测和业绩承诺，投资者不应据此假设进行投资决策。投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

三、本次发行的必要性和合理性

本次发行的必要性和合理性详见《盛美半导体设备（上海）股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》之"第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析"。

四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

（一）本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

公司自设立以来，一直致力于为全球集成电路行业提供领先的设备及工艺解决方案，坚持差异化国际竞争和原始创新的发展战略，通过自主研发，建立了较为完善的知识产权体系，凭借丰富的技术和工艺积累，形成了具有国际领先水平或先进水平的前道半导体工艺设备，包括清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管系列设备、前道涂胶显影Track设备、等离子体增强化学气相沉积PECVD设备、无应力抛光设备；后道先进封装工艺设备以及硅材料衬底制造工艺设备等。

公司凭借深耕集成电路设备产业多年而积累的集成应用经验，掌握了成熟的核心关键工艺技术、生产制造能力与原始创新的研发能力，拥有成熟的供应链管理和制造体系，同时契合集成电路产业链中下游应用市场所需。公司凭借领先的技术和丰富的产品线，已发展成为中国大陆少数具有一定国际竞争力的半导体设备供应商，产品得到众多国内外主流半导体厂商的认可，并取得良好的市场口碑。

本次发行所涉及的募投项目包括研发和工艺测试平台建设项目、高端半导体设备迭代研发项目以及补充流动资金，上述募投项目紧密围绕公司主营业务，是现有主营业务的延伸与拓展，符合公司长期发展规划及业务布局，顺应行业市场发展方向，与公司现有主营业务的发展具有较高的关联度。

本次募投项目的实施将进一步提升公司的市场竞争力，能够有效提高公司的研发实力，巩固并进一步提升公司行业竞争地位，实现公司的长期可持续发展。

（二）公司从事募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

1、人员储备

公司高度重视技术研发团队建设和培养，鼓励自主创新和独立研发。公司自设立以来，持续培养和引进全球行业内的专业人才，经过多年的积累，公司拥有了一支国际化、专业化的技术研发团队。公司核心技术研发团队具有国际竞争力，主要的核心技术人员大多有海外求学或从业经验，拥有国际化的视野和思维，有利于学习和掌握国际领先技术。此外，公司在韩国组建了专业的研发团队，依靠韩国在机械电子领域的技术人才，与中国大陆的研发团队取长补短。公司通过建立一支国际化、专业化的技术研发团队，并坚持差异化技术创新和竞争战略，保证了公司能够不断推出新产品，并不断改进现有产品，巩固和提升公司的技术研发能力。截至2024年12月31日，公司研发人员数量为931人，占公司员工总数的46.50%。报告期内，公司核心技术研发团队稳定，具有较强的技术研发团队优势。

未来，公司拟进一步加大研发投入，持续引入高层次人才，不断扩充公司研发团队规模，进一步提升研发团队综合能力与水平，为公司本次募集资金投资项目储备充足的人才。

2、技术储备

公司的主要产品包括前道半导体工艺设备，包括清洗设备、半导体电镀设备、立式炉管系列设备（包括氧化、扩散、真空回火、LPCVD、ALD）、涂胶显影Track设备、等离子体增强化学气相沉积PECVD设备、无应力抛光设备；后道先进封装工艺设备以及硅材料衬底制造工艺设备，通过多年的技术研发，公司在上述产品领域均掌握了相关核心技术，并在持续提高设备工艺性能、产能，提升客户产品良率和降低客户成本等方面不断进行创新。这些核心技术均在公司销售的产品中得以持续应用并形成公司产品的竞争力。

国家集成电路创新中心和上海集成电路研发中心有限公司于2020年6月20日对公司的核心技术进行了评估，并出具了《关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司核心技术的评估》，盛美上海的核心技术主要应用于半导体清洗设备、无应力抛光设备和电镀铜设备。这些核心技术均为盛美上海目主研发取得，与国内外知名设备厂商相比，SAPS兆声波清洗技术、TEBO兆声清洗技术、单晶圆槽式组合Tahoe高温硫酸清洗技术、无应力抛光技术、多阳极电镀技术等核心技术已达到国际领先或国际先进的水平。

在研发成果方面，持续的研发投入也为公司积累了大量技术成果，截至2024年12月31日，公司及控股子公司拥有已获授予专利权的主要专利470项，其中境内授权专利176项，境外授权专利294项，发明专利共计468项。伴随着近年研发成果与产业的深度融合，公司连续多年被评为"中国半导体设备五强企业"，入选首批上海市科学技术委员会颁发的企业重点实验室，SAPS兆声波清洗技术荣获2020年上海市科技进步一等奖。

公司目前已建立起较为完善的核心技术体系与技术成果保护制度，并形成了自主研发、设计、生产的完整技术成果转化体系，推动公司技术实现产业转化。因此，公司丰富的技术储备和出色的技术转化能力，为项目的实施提供了技术支撑。

3、市场储备

集成电路制造的技术复杂，工艺步骤繁多，生产所需的设备种类较多，单一设备的效率、可靠性等将直接影响整条生产线的工作效率和芯片产品的良率，因此集成电路制造企业对新设备的选择非常慎重，需要经过较长的验证周期。

公司凭借领先的技术和丰富的产品线，已发展成为中国大陆少数具有一定国际竞争力的半导体设备供应商，产品得到众多国内外主流半导体厂商的认可，并取得良好的市场口碑。公司产品已获得了包括海力士、华虹集团、中芯国际、长江存储、合肥长鑫、芯恩半导体、士兰微、晶合、比亚迪半导体、斯达、上海集成电路研发中心、盛合晶微、长电科技、通富微电、华天科技、芯德、德州仪器、中科智芯、渠梁电子、Nepes、金瑞泓、合晶科技、成都奕成、中科院微电子所、华进半导体、厦门联芯等客户的订单。通过与上述知名客户的合作，公司积累了较高的品牌、市场知名度，具有较强的示范效应，有助于公司进一步拓展潜在客户，具备良好的市场基础。

综上所述，公司本次募集资金投资项目在人员、技术、市场等方面均具有良好基础。随着募集资金投资项目的建设，公司将进一步完善人员、技术、市场等方面的储备，确保项目的顺利实施。

五、公司应对本次发行摊薄即期回报采取的措施

本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降，为了保护投资者利益，公司采取以下措施提升公司竞争力，以填补股东回报。

（一）迅速提升公司整体实力，扩大公司业务规模

公司本次发行后，公司的总资产将得到进一步提升，抗风险能力和综合实力明显增强，市场价值明显提升。公司将借助资本市场和良好的发展机遇，不断拓展主营业务规模，充分发挥公司在半导体专用设备领域的优势，推动公司持续、健康、稳定发展。

（二）加强内部管理、降低运营成本

公司将积极推进产品工艺的优化、工艺流程的改进、技术设备的改造升级，加强精细化管理，持续提升生产运营效率，不断降低生产损耗。同时，公司将加强预算管理，控制公司费用率，提升盈利水平。

（三）加快募集资金投资项目实施进度，加强募集资金管理

本次募集资金投资项目均围绕公司主营